

半導體材料加工技術研討會



中興大學機械工程學系 敬邀
半導體材料加工技術研討會 邀請函
敬愛的先進您好：

隨著半導體與第三代半導體材料在全球市場的需求日益提升，國內工具機產業正積極尋求進一步切入高硬脆材料加工應用之機會，期望拓展產品技術能量與國際競爭力。然而，半導體材料如 Si、SiC、GaN 等，其物理特性與加工行為與傳統金屬材料大相逕庭，包含極微細尺度控制、高精度去除機制與高度穩定的製程條件。對長期專注於金屬加工的工具機產業而言，仍需進一步了解這些製程特性，方能有效銜接並投入相關應用市場。

為協助產學界深化對半導體材料加工之理解，並促進產業轉型技術交流與合作，我們謹訂於 2025 年5月2日（星期五）假 國立中興大學機械工程學系 舉辦「半導體材料加工技術研討會」，由先進智慧製造技術聯盟 擔任主辦單位，誠摯邀請您撥冗蒞臨指導，共同參與本次技術分享盛會。

研討會資訊

日期：2025年5月2日（星期五）

地點：國立中興大學應用科技大樓419教室(台中市南區興大路145號)

時間	流程
9:30~10:00	報到
10:00~10:50	中興大學 陳政雄：半導體材料的超音波加工技術
10:50~11:10	Break
11:10~12:00	中正大學 鄭志鈞：半導體晶圓的精密研磨技術
12:00~13:00	Break
13:00~13:50	勤益科大 蔡明義：SiC 晶圓的精密拋光技術
13:50~14:10	Break
14:10~15:00	中央大學 何正榮：半導體與光電材料的精密雷射加工技術
15:00	研習會結束與會後交流